

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION 中芯國  
際集成電路製造有限公司\*  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：981)

## 有關框架協議的持續關連交易

### 訂框架協議

謹此提述本公司日期為二零一五年十二月二十八日的公告，內容有關二零一五年框架協議。由於二零一五年框架協議於二零一八年十二月三十一日屆滿，而其項下擬進行之交易將繼續按經常性方式訂立，本公司宣佈，已於二零一九年一月二十三日與大唐控股就非豁免持續關連交易簽訂框架協議，自二零一九年一月一日起為期三年。

### 上市規則的涵義

由於大唐控股為本公司主要股東大唐香港（於本公告日期持有本公司已發行股本約17.05%）的控股公司，故此，大唐控股為上市規則第14A章所指大唐香港的聯繫人，即本公司關連人士。

由於適用百分比率(盈利比率除外)按年度計高於0.1%但低於5%，根據上市規則第14A章，非豁免持續關連交易構成本公司之非豁免持續關連交易，並須符合申報，公告及年度審核的規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

## 序言

謹此提述本公司日期為二零一五年十二月二十八日的公告，內容有關二零一五年框架協議。由於二零一五年框架協議於二零一八年十二月三十一日屆滿，而其項下擬進行之交易將繼續按經常性方式訂立，本公司宣佈，已於二零一九年一月二十三日與大唐控股就非豁免持續關連交易簽訂框架協議，自二零一九年一月一日起為期三年。

### 框架協議的主要條款概要

簽立日期：                  二零一九年一月二十三日

有效期：                      由二零一九年一月一日起三年內有效

主要條款：                  本公司及其附屬公司同意與大唐控股及其聯繫人加強業務方面的合作，包括但不限於提供芯片加工服務。

### 定價政策

根據框架協議，合作業務方面的定價將依據市場合理價格決定（在正常及一般業務過程中根據正常商業條款以公平協商方式獲得或向獨立第三方提供之市價）或根據實際生產之成本加合理利潤（參考業界一般利潤幅度）之價格，及將按不遜於由獨立第三方向本公司或其附屬公司適用於出售或不高於由本公司或其附屬公司向獨立第三方出售適用於出售之條款釐定（如有）。關於本公司向大唐控股提供芯片代工服務，本公司將參考其就類似性質和數量的服務而提供給獨立第三方客戶的條款（包括定價）以及合理的市場價格（如適用）。

### 釐定建議最高限額的基準

建議預期最高限額相等於預期本公司在截至二零一九年十二月三十一日，二零二零年十二月三十一日和二零二一年十二月三十一日止三個年度內每年來自非豁免持續關連交易的最高收入，分別為 2,000 萬美元，3,500 萬美元及 4,800 萬美元。在釐定該等預期最高限額時，本公司已因應目前半導

體市場的情況及本公司的技術能力考慮到非豁免的持續關連交易的潛在擴展，並參考本公司以往來自大唐控股及其聯繫人的交易量，大唐控股在與客戶溝通的基礎上制定的未來業務計劃，以及本公司在二零一五年框架協議的交易中產生的過往收益。根據本公司截至二零一六年十二月三十一日及二零一七年十二月三十一日止年度之年報，本公司在二零一五年框架協議下所產生的截至二零一六年十二月三十一日及二零一七年十二月三十一日止年度收入分別大約為 1,790 萬美元和 2,020 萬美元。根據本公司管理賬目，本公司在二零一五年框架協議下所產生的截至二零一八年十二月三十一日止年度收入大約為 1,730 萬美元。

### 訂立框架協議的原因及益處

本公司認為大唐控股在國內半導體行業佔有重要的地位。透過與大唐控股訂立框架協議及非豁免持續關連交易，本公司相信大唐控股能為本公司帶來持續長久的經營商機，且有利於推動本公司的技術發展。

董事（包括獨立非執行董事）認為該等非豁免持續關連交易屬本公司在其日常業務中按一般商務條款進行、屬公平合理，並符合本公司及股東整體上的利益。

概無董事被視為於框架協議擁有重大權益，而導致該董事須於董事會會議中就授權訂立此框架協議放棄投票。

### 上市規則的涵義

由於大唐控股為本公司主要股東大唐香港（於本公告日期持有本公司已發行股本約 17.05%）的控股公司，故此，大唐控股為上市規則第 14A 章所指大唐香港的聯繫人，即本公司關連人士。

由於適用百分比率(盈利比率除外)按年度計高於 0.1%但低於 5%，根據上市規則第 14A 章，非豁免持續關連交易構成本公司之非豁免持續關連交易，並須符合申報，公告及年度審核的規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

## 一般資料

### 本公司之資料

本公司是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國內地技術最全面、配套最完善、規模最大、跨國經營的集成電路製造企業，提供 0.35 微米到 28 納米不同技術節點的晶圓代工與技術服務。本公司總部位於中國上海，擁有全球化的製造和服務基地。在上海建有一座 300mm 晶圓廠和一座 200mm 晶圓廠；在北京建有一座 300mm 晶圓廠和一座控股的 300mm 先進制程晶圓廠；在天津和深圳各建有一座 200mm 晶圓廠；在江陰有一座控股的 300mm 凸塊加工合資廠；在意大利有一座控股的 200mm 晶圓廠。本公司還在美國、歐洲、日本和台灣地區設立行銷辦事處、提供客戶服務，同時在香港設立了代表處。

### 大唐控股之資料

大唐香港為大唐控股的全資子公司而大唐控股為大唐電信科技產業集團（「大唐電信集團」）的全資子公司。大唐電信集團的總部位於中國北京，目前已形成無線移動通信、集成電路、戰略性新興產業等產業板塊。作為我國無線移動通信自主創新的主力軍和踐行創新型國家戰略的典範，先後主導提出 3G TD-SCDMA 和 4G TD-LTE-Advanced 國際標準，推動 TD 成功實現產業化、規模商用和國際市場重點突破，引領我國 5G 核心技術標準研發。同時，打通移動通信和集成電路產業鏈，形成移動通信與集成電路互動發展模式，實現我國通信芯片從“無芯”到“有芯”再到“強芯”的關鍵轉變，大幅提升我國信息通信產業國際競爭力。

## 釋義

在本公告內，除文意另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「二零一五年框架協議」 指本公司與大唐控股簽訂日期為二零一五年十二月二十八日的框架協議，如本公司日期為二零一五年十二月二十八日的公告所述

「聯繫人」 具有上市規則所賦予的涵義

「董事會」 指本公司董事會

「本公司」	指中芯國際集成電路製造有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其普通股及美國預託股份分別在聯交所及紐約證券交易所上市
「關連人士」	具有上市規則所賦予的涵義
「大唐香港」	指大唐控股（香港）投資有限公司，於香港註冊成立的公司並為大唐控股的全資附屬公司
「大唐控股」	指大唐電信科技產業控股有限公司（一家根據中國法律註冊成立的公司）
「董事」	指本公司的董事
「預期最高限額」	指截至二零一九年、二零二零及二零二一年十二月三十一日止三年內，預期每年來自非豁免持續關連交易的總計最高收入
「框架協議」	指本公司與大唐控股於二零一九年一月二十三日簽訂的框架協議
「香港」	指中國香港特別行政區
「上市規則」	指香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「不獲豁免持續關連交易」	指框架協議訂明的交易
「中國」	指中華人民共和國（就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣）
「股份」	指本公司股本中每股面值 0.004 美元於聯交所上市的普通股
「股東」	指股份的持有人
「聯交所」	指香港聯合交易所有限公司

「主要股東」	具有上市規則所賦予的涵義
「TD-SCDMA」	指時分雙工-同步碼分多址，是現時在中國開發的 3G 或第三代移動電話標準及科技移動電信標準
「TD-LTE」	指時分長期演進，是現時在中國開發的 4G 或第四代移動電話標準及科技移動電信標準
「美國」	指美利堅合眾國
「美元」	指美國的法定貨幣美元
「%」	指百分比

承董事會命  
中芯國際集成電路製造有限公司  
高永崗  
執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書

中國，上海  
二零一九年一月二十三日

於本公告日期，本公司董事分別為：

**執行董事**

周子學（董事長）  
趙海軍（聯合首席執行官）  
梁孟松（聯合首席執行官）  
高永崗（首席財務官兼聯席公司秘書）

**非執行董事**

陳山枝  
周杰  
任凱  
路軍  
童國華

**獨立非執行董事**

William Tudor Brown  
蔣尚義  
叢京生  
劉遵義  
範仁達

\* 僅供識別